

トランスクリプト

司会：冒頭のあいさつ

それでは、お時間となりましたので、東京エレクトロン株式会社 2023年3月期第1四半期の決算説明会を開始いたします。本日はお忙しい中、ご参加いただきまして、誠にありがとうございます。わたくし、司会進行を務めます、IR室の八田です。よろしくお願いいたします。

それでは、本日の出席者の紹介をいたします。代表取締役社長・CEO 河合利樹でございます。

河合：河合でございます。よろしくお願いいたします。

続きまして、執行役員 Global Business Platform 副本部長 ファイナンス担当 川本弘でございます。

川本：川本でございます。本日はよろしくお願いいたします。

プレゼンテーションに先立ち、私から、本日の会の流れについてご説明させていただきます。これより、川本、河合のプレゼンテーションをお聞きいただきます。その後 18:00 まで、質疑応答のお時間を設け、皆さまからのご質問をお受けしたいと思っております。本説明会は、Webex を 2 回線使い、日英の同時通訳でおこなっております。先日、メールでご案内させていただいたとおり、音声のみお聞きになりたい方は、電話でもご参加いただけますが、ご質問されたい方は、PC もしくはモバイル端末のアプリをお使いください。また、本説明会は機関投資家様・アナリストさま向けの説明会となっております。大変申し訳ございませんが、回答は、従来通り機関投資家・アナリストの方々のご質問に限らせていただきます。本説明会につきましては、後日、日英の音声配信をウェブサイト上に掲載しますので、こちらも併せてご利用ください。

それでは、はじめに、執行役員 川本より、「連結決算の概要」についてご説明申し上げます。よろしくお願いいたします。

第1四半期 連結決算の概要

川本 弘（執行役員 ファイナンスユニット GM、Global Business Platform 本部 副本部長）

皆さま、こんにちは。ファイナンス部門を担当しております川本でございます。今回より決算説明会に登壇させていただきます。では早速、2023年3月期 第1四半期の当社連結決算の概要について、ご説明申し上げます。

損益状況：スライド 4

第1四半期の連結売上高は、前四半期比 16%減少の 4,736 億円となりました。セグメント別に見ますと、主力の SPE 売上高は 4,640 億円、FPD 売上高は、96 億円となりました。

売上総利益率は 42.3%、営業利益率は 24.8%となりました。売上高につきましては、前期に前倒しで計上したことに加え、出荷の後ろ倒しによって売上計上時期が Q2 にずれたために、前四半期比では減少しておりますが、計画に対して順調に進む予定でございます。

トランスクリプト

また、利益率につきましても、売上高の減少に加え、積極的な開発投資を継続していること、また前中期経営計画の前倒し達成、新しい中期経営計画の期待も込めて、社員への特別賞与を今回支給しました。その結果、前四半期比で利益率は低下いたしました。計画につきましては、下期にかけて売上・利益ともに増加を見込んでおります。

損益状況：スライド 5

こちらは、先ほどご説明させていただいた業績を時系列でグラフに示したものになります。ご確認くださいだければと思います。

セグメント情報：スライド 6

こちらは、セグメント情報の時系列でございます。主力のSPEは、売上高4,640億円、利益率は28.8%となりました。Q4と比べますと売上の減少となりました。製品ミックスなどの影響を受けまして、利益率も低下しております。FPDについては、売上高96億円、利益率は-6.4%となりました。都市封鎖などによる物流の混乱の影響もありまして、売上の計上タイミングが一部後ろ倒しとなり売上が減少したことで、このQ1は利益率がマイナスとなっておりますが、今期計画の達成に向けては今後順調に推移していく予定でございます。なお、売上構成比としては、この四半期は、SPEが98%、FPDは2%となっております。

SPE部門 新規装置 製品別売上構成比：スライド 7

こちらは、「SPE部門の地域別売上高」になります。この第1四半期に関しましては売上が減少しておりますので、すべての地域で減少となりましたが、主に韓国・中国のメモリ向けが減少しました。中国地域におきましては、前四半期に引き続き、地場のお客さまの構成比が多くを占めております。

SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比：スライド 8

こちらは、SPE部門の「新規装置のアプリケーション別売上構成比」になります。棒グラフの一番右側をご覧ください。下から、ロジック64%、不揮発性メモリが20%、DRAMが16%となりました。DRAM向けが四半期比で減少しておりますので、メモリに対してロジックの構成比が上昇いたしました。

フィールドソリューション売上：スライド 9

こちらは、「フィールドソリューション売上高」になります。第1四半期は、1,095億円となりました。売上の変動が大きい、改造案件が第1四半期は減少したことにより、前四半期比で売上は若干減少しましたが、堅調な推移を見せております。また、パーツビジネスにつきましても、お客さまの高い稼働率を受け、堅調に推移いたしました。

貸借対照表：スライド 10

続きまして、貸借対照表を説明いたします。資産合計は、1兆8,469億円となりました。現金同等物は、3,146億円と前四半期から減少しております。こちらはこの四半期に、株主さまへの配当をお支払いしたこと、また納税等もございました。それらの影響により現金同等物は減少いたしました。売上債権及

トランスクリプト

び契約資産は、4,261億円。棚卸資産は、5,572億円となりました。棚卸資産につきましては、Q2以降に売上計上予定の工場の仕掛品、工場の製品などが増加したことにより、増加いたしております。

負債・純資産でございますが、負債は5,320億円。純資産は1兆3,148億円となりました。純資産につきましては、純利益の計上はございましたが、株主さまへの配当等があり、ネットではマイナスになりました。ご参考までに、自己資本比率は前期末同等の70.4%でございます。

キャッシュ・フロー：スライド 11

最後に、キャッシュ・フローについて簡単に触れさせていただきます。営業キャッシュ・フローは699億円。設備等の投資キャッシュ・フローは▲166億円。配当を中心とする財務キャッシュ・フローは▲1,191億円となりました。営業キャッシュ・フローから投資キャッシュ・フローを差し引いたフリーキャッシュ・フローは、533億円となっております。

以上、簡単ではございますが、決算の概要についてご報告させていただきました。

司会：次のプレゼンテーションの紹介

それでは、続きまして、CEO 河合より、「事業環境および業績予想」について、ご説明申し上げます。よろしくお願いたします。

事業環境および業績予想

河合 利樹（代表取締役社長・CEO）

皆さん、こんにちは。改めて、河合でございます。本日はお忙しいところお時間をつくっていただきましてありがとうございます。それでは私の方から「事業環境および業績予想」についてご説明申し上げます。

CY2022 事業環境（2022年8月時点での見方）：スライド 13

まず、事業環境についてご説明いたします。5月の決算報告時には、今年のWFE市場について、2割程度の成長を見込むとお伝えしましたが、今回、前年比5%~15%の成長に修正いたします。インフレ対策としての金利上昇、ゼロコロナ政策、これらによる一時的なPC、スマートフォンの購買意欲の抑制、加えて、部材不足や物流の混乱、大幅な為替変動の影響、これらのことを総合的に考慮した結果です。一方、社会のデジタルシフトの進展、脱炭素社会の実現に向けた半導体の技術革新への期待より、当業界の中長期的な成長に対する見方に変更はございません。

FPD TFT アレイ工程向け製造装置市場については、変更なく、前年比微増を見込んでいます。

CY2022 アプリケーション別のWFE市場環境：スライド 14

続きまして、WFE市場のアプリケーション別の見通しについては、スライドのとおり変更しておりません。

トランスクリプト

ロジック/ファウンドリは、前年比 10%~20%の増加に、DRAM は、前年比 5%程度の減少に、それぞれ修正いたしました。不揮発性メモリにつきましては、見方に変更なく、前年比 10%程度の増加を見込んでおります。

投資環境は日々変化しておりますが、それぞれのアプリケーションにおいて、技術革新は留まることなく進展しており、最先端の半導体技術開発を、お客さまやパートナー企業とともに進めてまいります。

FY2023 Q1 事業進捗：スライド 15

次に、FY2023 第一四半期の事業進捗についてご説明します。

今年 6 月に、新中期経営計画を策定しました。新たな財務モデルとして、FY2027 までに、売上高 3 兆円以上、営業利益率 35%以上、ROE30%以上という目標を掲げました。また、さらなる企業価値の向上を目指し、新たなビジョンを制定しました。新ビジョンは、「半導体の技術革新に貢献する、夢と活力のある会社」です。社会における、半導体の重要性がますます高まる中、半導体製造装置のリーディングカンパニーとして、お客さまの技術ニーズに応え、最先端の製品とサービスを提供し、営業利益 1 兆円以上、営業利益率 35%以上という、ワールドクラスの利益創出を目指してまいります。

また同時に、世界の共有価値である「デジタル化の推進と脱炭素」に向け、半導体の技術革新を追求することで、社会課題の解決に貢献してまいります。2050 年に、温室効果ガスの実質排出量をゼロにすること、すなわち、“ネットゼロ”の実現に向けた中長期環境目標を掲げました。スコープ 1 とスコープ 2 を 2040 年までに、スコープ 3 を 2050 年までに実現できるよう、取り組んでまいります。

これら、中期経営計画の実現のために、5 年間で 1 兆円以上の積極的な研究開発投資を計画しています。足元では、さまざまな不確定要素もありますが、われわれへの期待、われわれが果たすべき役割は、さらに大きくなっていると認識しております。短期、および中長期の利益を同時に志向するとともに、継続的な企業価値の向上を目指し、取り組んでまいります。

FY2023 業績予想：スライド 16, 17

次に、FY2023 の業績予想について説明いたします。

先ほどのとおり、マクロ経済の影響を考慮し、WFE に対する見方を修正しましたが、お客さまの投資については今のところ軽微な調整であり、業績予想は据え置きました。引き続き、市場環境については注視していく所存です。

FY2023 SPE 部門 新規装置売上予想：スライド 18

次に、FY2023 の SPE 部門 新規装置の売上予想についてご説明します。こちらも、上期、下期とも、売上予想に変更はなく、上期 8,500 億円、下期 1 兆円の見込みです。今上期の売上予想を四半期ごとに分解すると、右の図のようになります。Q1 は、一部装置の出荷時期のずれが発生しましたが、計画には変更ありません。Q2 は、四半期で過去最高の売上見込みとなっております。

トランスクリプト

FY2023 研究開発費・設備投資計画：スライド 19

次に、研究開発費と設備投資の計画です。こちらは変更ございません。新中期経営計画の達成に向け、積極的な研究開発と設備投資を継続してまいります。

FY2023 配当予想：スライド 20

最後に、配当予想についてですが、こちらも変更ございません。

今期の業績予想と、配当性向 50%に基づき、1株当たりの配当は、通期で 1,678 円を予定しております。過去最高の配当額となる見込みです。

以上、私からのご説明とさせていただきます。ありがとうございました。